

## SMT-Stiftleisten RM 2,00mm, liegend, 1-/2-reihig SMT Pin Headers, 2.00mm Pitch, Horizontal, Single/Double Row

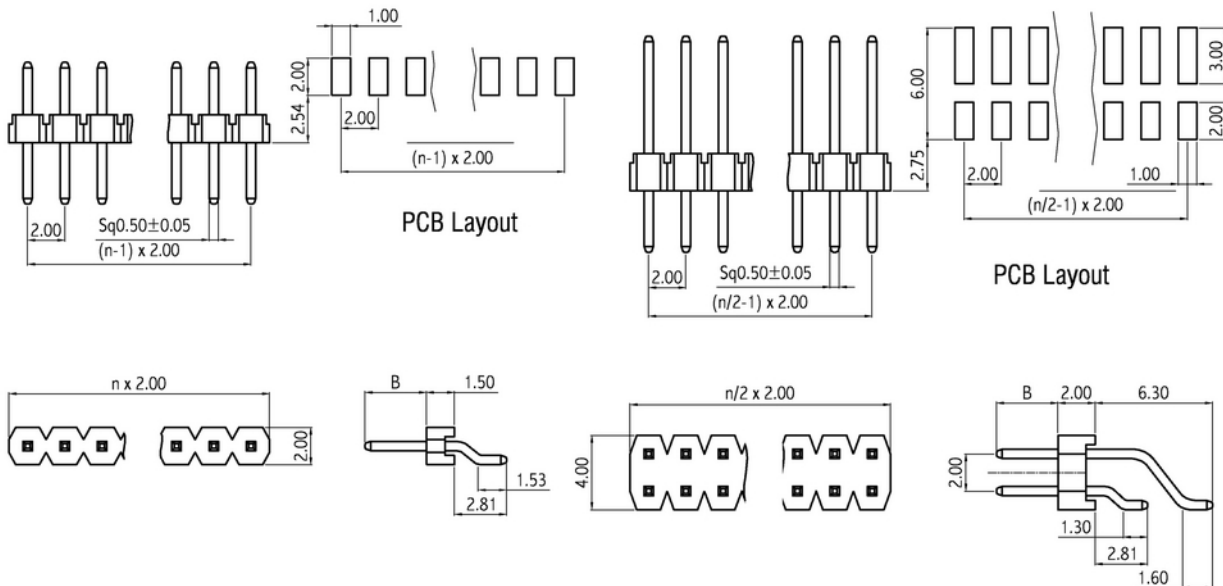
### Technische Daten / Technical Data

Isolierkörper	Thermoplastischer Kunststoff, nach UL94 V-0
Insulator	Thermoplastic, rated UL94 V-0
Kontaktmaterial	Vierkantstift 0,50mm, Kupferlegierung
Contact Material	0.50mm square pin, copper alloy
Kontaktoberfläche	Lt. Oberflächenoptionen, über Ni (1,3 ... 2,5µm)
Contact Surface	Acc. to options (see below), over Ni (1.3 ... 2.5µm)
Lötbarkeit	IEC 60512-12A
Solderability	IEC 60512-12A
Durchgangswiderstand	< 20mΩ
Contact Resistance	< 20mΩ
Isolationswiderstand	> 500MΩ
Insulation Resistance	> 500MΩ
Spannungsfestigkeit	500V <sub>AC</sub>
Test Voltage	500V <sub>AC</sub>
Nennspannung	250V <sub>AC</sub>
Voltage Rating	250V <sub>AC</sub>
Nennstrom	1A
Current Rating	1A
Temperaturbereich	-40°C ... +125°C
Temperature Range	-40°C ... +125°C
Verarbeitung	Reflow-Lötverfahren
Processing	Reflow soldering



© W+P PRODUCTS

Passende Buchsenleisten:  
Mate with Female Headers:  
**4160 7450 7451 6193** etc.  
Weitere siehe Kapitel B  
Please see ch. B for more

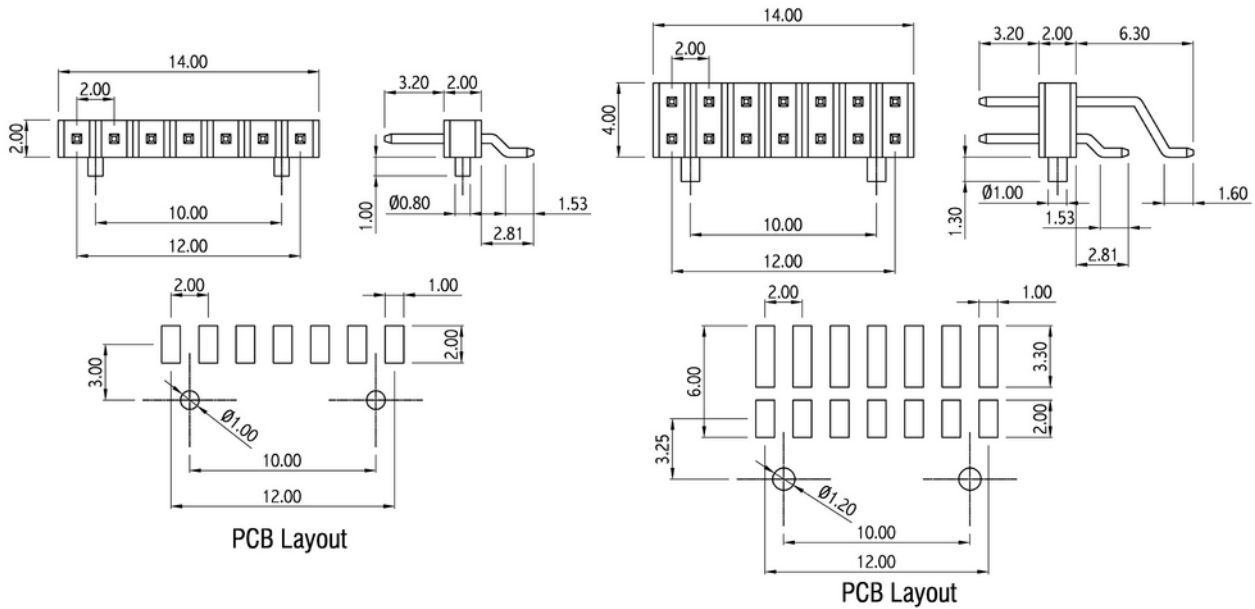


Series	Contacts*	Rows*	Dimensions*	Plating*	Loc. Peg	Packaging*
<b>7353</b>	<b>36</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>50</b>	<b>00</b>	<b>PPST</b>
	04-36 Einreihig Single row 06-72 Zweireihig Double row	1 Einreihig Single row 2 Zweireihig Double row	10 B=3,20mm 11 B=4,45mm 99 Kundenspezifisch Customer-specific	00 Vergoldet Gold plated 50 Verzinkt Tin plated 60 Sel Au/Sn Duplex plating	00 Ohne Pos.hilfe W/o locating peg	ST PPST PPTR

# 7353

SMT-Stiftleisten RM 2,00mm, liegend, 1-/2-reihig

SMT Pin Headers, 2.00mm Pitch, Horizontal, Single/Double Row



Series	Contacts*	Rows*	Dimensions*	Plating*	Loc. Peg	Packaging*
<b>7353</b>	<b>20</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>00</b>	<b>10</b>	<b>ST</b>
	04-36 Einreihig Single row 06-72 Zweireihig Double row	1 Einreihig Single row 2 Zweireihig Double row	10 B=3,20mm 11 B=4,45mm 99 Kundenspezifisch Customer-specific	00 Vergoldet Gold plated 50 Verzinkt Tin plated 60 Sel. Au/Sn Duplex plating	10 Mit Pos.hilfe With locating peg	

**Lieferformen / Packaging Options:**

**ST** In Stangen ohne Pick&Place-Pad / In tubes w/o Pick&Place-Pad

**PPST** In Stangen mit P&P-Pad / In tubes with P&P-Pad

**PPTR** Tape & Reel mit P&P-Pad / Tape & Reel with P&P-Pad

s. Optionen / s. Options

\* Dies ist ein **Bestellbeispiel** - bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.  
\* This is an **order example** - please replace by your specifications.

## Informationen zum Reflow-Lötverfahren Reflow Soldering Information

### Reflow-Löttempfehlung Reflow Soldering Recommendation

Die Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Löten im Reflow-Verfahren verarbeitet werden (Maximalwerte).

Profileigenschaft	Kennwert
Temperatur Minimum $T_{Smin}$	150°C
Temperatur Maximum $T_{Smax}$	200°C
Dauer $T_{Smin} - T_{Smax}$	60-180s
Temperatur Lötbereich $T_L$	217°C
Verweildauer oberhalb $T_L$	60-180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3°C / s
Höchsttemperatur $T_P$	260°C ±5
Dauer Höchsttemperatur	20-40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6°C / s
Dauer 25°C - Höchsttemperatur $T_P$	Max. 8 min

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature profile for leadfree reflow soldering (maximum values).

Profile Feature	Key Values
Minimum Temperature $T_{Smin}$	150°C
Maximum Temperatur $T_{Smax}$	200°C
Duration $T_{Smin} - T_{Smax}$	60-180s
Soldering Range Temperature $T_L$	217°C
Duration above $T_L$	60-180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3°C / s
Peak Temperature $T_P$	260°C ±5
Duration Peak Temperature	20-40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6°C / s
Duration 25°C - Peak Temp. $T_P$	Max. 8min

